## 特許協力条約

REC'D	30	JAM	2006
WIPO			PCT

PCT

特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第二章)

(法第 12 条、法施行規則第 56 条) [PC T 36 条及びPC T規則 70]

			1
代理人 今後の手続きについては、様式PCT/IPEA/416を参照すること。 SF-1111			
国際出願日(日. 月. 年) 14. 10.	<b>1</b>		2003
04 (2006. 01)			
`			
	成された国際予備	審査報告である。	
の規定に使い达打する。			
を含めて全部で4	ページカ 	ゝらなる。	
れている。 			
(PCT規則 70.16 及U共和	100 民民民	,,,	
示したように、出願時におり	<b>する国際出願の開</b> え	示の範囲を超えた補正を含	含むものとこの
すように、電子形式による配	記列表又は配列表		
容を含む。			
査報告の基礎			
歩性又は産業上の利用可能性性の欠如 性の欠如 (2)に規定する新規性、進歩 文献及び説明  用文献  不備   対する意見	生についての国際	予備審査報告の不作成 ]用可能性についての見解	、それを裏付
性の欠如 (2)に規定する新規性、進歩 文献及び説明  用文献  不備  対する意見	性又は産業上の利 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	J用可能性についての見解 	、それを裏付
性の欠如 (2) に規定する新規性、進歩 文献及び説明  用文献 O不備 -対する意見	性又は産業上の利 国際予備審査報告で 16.	J用可能性についての見解 を作成した日 01.2006	
性の欠如 (2) に規定する新規性、進歩 文献及び説明  用文献 O不備 -対する意見	性又は産業上の利 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	J用可能性についての見解 ≥作成した日 01.2006 	
	国際出願日 (日. 月. 年) 14. 10. 04(2006.01)  この国際予備審査機関で作の規定に従い送付する。 さ合めて全部で 4 これている。 ページである。 は礎とされた及び/又はこの (PCT規則 70.16 及び実施 示したように、出願時においした差替え用紙 すように、電子形式による配容を含む。	国際出願日 (日. 月. 年) 14. 10. 2004  04(2006.01)  この国際予備審査機関で作成された国際予備の規定に従い送付する。 。 さ合めて全部で 4 ページかいれている。 。 ページである。  基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関(PCT規則70.16及び実施細則第607号参照示したように、出願時における国際出願の開えした差替え用紙  すように、電子形式による配列表又は配列表目容を含む。	国際出願日 (日. 月. 年) 14. 10. 2004

Id Hi ter-ba >							
第 I 欄 報告の基礎							
1. 言語に関し、この予備審査報告は以下のものを基礎とした。							
1000 mm 1	では想象なられる。この国際出願の翎級文						
□ 出願時の言語から次の目的のための言語である	語に翻訳された、この国际山頭の知识へ						
国際調査 (PCT規則12.3(a)及び23.1(b))	ļ.						
□ 国際公開 (PCT規則12.4(a)) □ 国際予備審査 (PCT規則55.2(a)又は55.3(a))	į						
	* 世帯に甘べく会会に広答するために提出され						
2. この報告は下記の出願書類を基礎とした。 (法第6条 (PCT14条) の規定に基づく命令に応答するために提出され た差替え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。)							
た差替え用紙は、この報告において、出版が、この、このでは、							
☑ 出願時の国際出願書類							
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□							
0 11 mm of 11 mm	れたもの						
第	付けで国際予備審査機関が受理したもの						
第 ページ*、	付けで国際予備審査機関が受理したもの						
「請求の範囲							
重 出頭時に提出さ	されたもの						
第	けで国際予備森査機関が受理したもの はない。						
第	付けで国際予備審査機関が受理したもの						
第							
図面	されたもの						
第ページ/図、 III MATCHEN	一 付けで国際予備審査機関が受理したもの						
第ページ/図*、	付けで国際予備番金機関が受達したもの						
□ 配列表又は関連するテーブル							
配列表に関する補充欄を参照すること。							
and a series of the series of							
3. 🗍 補正により、下記の書類が削除された。							
□ 明細書 第	ページ 項						
□ 配列表 (具体的に記載すること)							
□ 配列表に関連するテーブル(具体的に記載すること)							
	14 A TOTAL & AND THE A PART A						
4. □ この報告は、補充欄に示したように、この報告に添付されかっ えてされたものと認められるので、その補正がされなかったも	D以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超し ・のとして作成した。(PCT規則 70.2(c))						
えてされたものと認められるので、その補止がされなかったも	SOL O CIPACOLES (1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1						
□ 明細書 第	ページ						
The second of th							
□ 配列表(具体的に記載すること) □ 配列表に関連するテーブル(具体的に記載すること)							
* 4. に該当する場合、その用紙に "superseded" と記入されることだ	<b>ぶある。</b>						

第1	7個 新規性、進歩性又は産業上 それを裏付ける文献及び説	の利用可能性についての法第 12 条 (PCT35 条(2)) に定める 明	見解、 
1.	見解		
	新規性(N)	請求の範囲 請求の範囲 1-7	
	進歩性(IS)	請求の範囲 請求の範囲 <u>1-7</u>	有 無
	産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲 <u>1-7</u> 請求の範囲	

2. 文献及び説明 (PCT規則 70.7)

文献 1 : JP 2001-196404 A(富士通株式会社) 2001.07.19, 段落[0054]-[0057], 図 19, 20 & US 6462415 B1

請求の範囲1-7に係る発明は、文献1に、基材の片面に貼付する半導体ウエハの外径よりも小径の粘着剤層が形成されていない開口部と、その外周に形成された 粘着剤層が形成されている部分とが設けられた表面保護シートを裏面研削に用い る点が記載されているので、新規性、進歩性を有しない。

請求の範囲5に係る発明の基材シートと粘着剤層とを積層貼付する点は、文献1 の表面保護シートは、基材シートと粘着剤層とから構成されているから、当該積層 構造を形成する際に、積層貼付によって積層構造を形成することは、当業者にとっ て自明である。

また、最も外に配置されているバンプの位置とウエハの外周からの距離は、回路面に形成されるバンプの数やウエハ面に形成される回路素子の大きさや数等に応じて、当業者が適宜決定すべき事項であって、請求の範囲6に係る発明の最も外に配置されているバンプの位置とウエハの外周からの距離を2-10mmとする点は、当業者にとって自明である。

第VI欄 ある種の引用文献 1. ある種の公表された文書(PCT規則 70.10) 出願日 優先日(有効な優先権の主張) 公知日 出願番号 (日.月.年) (日.月.年) (日. 月. 年)\_\_\_\_ 特許番号 JP 2004-288725 A 14. 10. 2004 19. 03. 2003  $\lfloor E X \rceil$ 書面による開示以外の開示の日付 書面による開示以外の開示に言及している **掛面による開示以外の開示の種類** 書面の日付(日.月.年) (日.月.年)\_\_\_\_\_\_